

中国电子学会

关于中国电子学会优博论坛（2026）

墙报交流征稿的通知

为加快高水平科技自立自强，一体推进教育科技人才发展，围绕创新需求加快建设国家战略人才力量，加大对青年科技人才的培养和支持力度，中国电子学会持续开展博士/硕士学位论文激励计划。为展示青年科技人才研究成果、搭建学术交流平台，中国电子学会联合电子科技大学将于2026年10月30日至11月1日在成都举办“中国电子学会优博论坛（2026）”，围绕电子信息及相关交叉领域科技前沿和产业发展，打造展示创新成果和开展学术交流平台。

本次论坛将设立“学术成果交流区”并开展墙报交流活动，现面向电子信息领域青年学者征集展示墙报，有关事项通知如下。

一、时间和地点

时间：2026年10月30日—11月1日

地点：四川省成都市

二、墙报联席主席

章文通 电子科技大学

李晶晶 电子科技大学

李中余 电子科技大学

三、征集对象

2016—2024 年中国电子学会博士/硕士学位论文激励计划
入选论文作者

2025 年博士/硕士学位论文激励计划参评者

其他电子信息相关领域青年人才

四、征集内容

本次墙报征集范围广泛，既欢迎原创性未发表的研究工作，也欢迎已在高水平期刊和会议上发表的成果。

原创性未发表工作要求研究已完成核心验证，取得实质性研究结果。已发表论文方面，欢迎作者将近两年来在电子信息领域顶刊顶会上发表的成果，以墙报形式进行展示交流。

以下为建议的期刊/会议列表（包含但不限于以下列表）：

【电子领域】

会议：ISSCC、DAC、ICCAD、VLSI Symposium、IEDM、
IMS、OFC

期刊：JSSC、TED、TCAS-I、TVLSI、EDL、TAP

【计算机领域】

会议：NeurIPS、ICML、CVPR、ICCV、ACL、ISCA

期刊：TPAMI、IJCV、JMLR、TOG、TIFS、ACM Computing
Surveys

【信通领域】

会议：IEEE INFOCOM、IEEE ICC、IEEE GLOBECOM、ISIT、IEEE ICASSP、ACM MobiCom、SIGCOMM、NSDI、WCNC

期刊：JSAC、TIT、TCOM、TWC、TSP、IEEE Communications Magazine

五、墙报激励计划

本次论坛将设立“墙报激励计划”，遴选部分墙报作者入选；同时设置人气墙报评选环节，由广大现场参会者投票选出。此外，多家期刊编辑将到场观摩墙报，优秀作者有机会获得期刊约稿邀请。

六、投稿方式与截止日期

（一）投稿方式：请将墙报电子版通过学术投稿系统提交。审核结果将通过邮件通知，请确保联系方式准确有效。

（二）报名截止时间：2026年8月15日。

七、墙报规格

墙报为竖版A0尺寸（841mm宽 × 1189mm高），版式不限。审核通过后由作者自行打印制作，并携带至论坛现场进行交流。

注意：参会需注册，具体注册方式及论坛其他事宜请关注后续通知。

八、联系方式

联系人：冯珂

邮 箱：fengke@ejournal.org.cn

电 话：13051649095；010-68600739

